

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**上海復旦微電子集團股份有限公司**  
**Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited\***  
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1385)

**2025年度業績公告**

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及附屬公司(「本集團」)截至2025年12月31日止年度之經審核合併業績連同截至2024年12月31日止年度經審核之比較數字。有關本公告內的財務業績已獲本公司外部核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)認可。

**合併資產負債表**

於 2025 年 12 月 31 日

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2025 年	2024 年
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		1,298,621,710.02	1,087,494,485.36
交易性金融資產		180,133,750.68	140,423,986.11
應收票據	1	296,994,501.37	298,713,176.51
應收賬款	2	1,876,899,180.89	1,493,805,646.24
應收款項融資		190,455,252.30	146,984,229.37
預付款項		346,455,226.64	113,644,331.24
其他應收款		5,802,950.31	9,833,164.05
存貨		2,636,594,349.55	3,134,456,903.75
其他流動資產		27,539,158.57	55,622,669.89
<b>流動資產合計</b>		<b>6,859,496,080.33</b>	<b>6,480,978,592.52</b>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資		46,892,929.09	54,181,165.60
其他權益工具投資		55,347,871.25	34,816,060.94
固定資產		1,467,987,999.20	1,567,673,557.56
在建工程		81,428,048.12	54,802,756.87
使用權資產		41,875,235.62	21,412,383.49
無形資產		310,123,944.62	197,495,198.20
開發支出		204,362,592.25	502,272,190.99
長期待攤費用		50,152,070.41	50,444,603.53
遞延所得稅資產		17,542,624.19	12,150,568.25
其他非流動資產		69,926,424.80	64,885,721.14
<b>非流動資產合計</b>		<b>2,345,639,739.55</b>	<b>2,560,134,206.57</b>
<b>資產總計</b>		<b>9,205,135,819.88</b>	<b>9,041,112,799.09</b>

**負債和股東權益****流動負債**

短期借款		<b>675,896,654.17</b>	1,071,872,039.08
應付賬款	3	<b>233,204,494.78</b>	234,621,512.71
合同負債		<b>127,777,512.09</b>	103,194,260.37
應付職工薪酬		<b>212,158,413.45</b>	164,318,991.66
應交稅費		<b>37,303,192.73</b>	38,398,088.82
其他應付款		<b>68,838,190.24</b>	76,683,635.99
一年內到期的非流動負債		<b>175,772,810.70</b>	368,203,159.44
其他流動負債		<b>175,187,801.73</b>	167,099,502.06

**流動負債合計**

		<b>1,706,139,069.89</b>	2,224,391,190.13
--	--	-------------------------	------------------

**非流動負債**

長期借款		<b>637,126,685.00</b>	239,863,539.60
租賃負債		<b>31,738,955.78</b>	8,582,179.88
遞延收益		<b>35,374,548.33</b>	20,516,501.67
預計負債		<b>34,035,079.00</b>	-
遞延所得稅負債		<b>6,538,728.07</b>	3,638,465.02

**非流動負債合計**

		<b>744,813,996.18</b>	272,600,686.17
--	--	-----------------------	----------------

**負債合計**

		<b>2,450,953,066.07</b>	2,496,991,876.30
--	--	-------------------------	------------------

**股東權益**

股本	4	<b>82,371,325.00</b>	82,142,730.00
資本公積		<b>1,939,566,639.74</b>	1,882,822,116.58
其他綜合收益		<b>33,345,873.50</b>	16,211,183.24
盈餘公積		<b>41,185,662.50</b>	41,071,365.00
未分配利潤	5	<b>4,038,346,732.33</b>	3,871,837,648.79

**歸屬於母公司股東權益合計**

		<b>6,134,816,233.07</b>	5,894,085,043.61
--	--	-------------------------	------------------

**少數股東權益**

		<b>619,366,520.74</b>	650,035,879.18
--	--	-----------------------	----------------

**股東權益合計**

		<b>6,754,182,753.81</b>	6,544,120,922.79
--	--	-------------------------	------------------

**負債和股東權益總計**

		<b>9,205,135,819.88</b>	9,041,112,799.09
--	--	-------------------------	------------------

## 合併利潤表

截至 2025 年 12 月 31 日止年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2025 年	2024 年
<b>營業收入</b>	7	<b>3,982,261,101.52</b>	3,590,223,828.23
減：營業成本	7	<b>1,744,807,063.30</b>	1,581,600,939.97
税金及附加	8	<b>24,722,545.76</b>	11,783,676.78
銷售費用		<b>238,793,628.27</b>	242,133,769.33
管理費用		<b>184,127,203.14</b>	158,443,584.15
研發費用	9	<b>1,222,742,123.48</b>	1,030,651,521.72
財務費用		<b>31,876,216.42</b>	28,666,755.68
其中：利息費用		<b>38,076,618.07</b>	42,712,216.50
利息收入		<b>16,073,359.98</b>	16,796,059.39
加：其他收益		<b>142,995,060.40</b>	233,599,228.29
投資(損失)/收益		<b>(1,852,932.19)</b>	513,788.17
其中：對聯營企業和合營企業			
的投資損失		<b>(5,564,320.89)</b>	(3,430,403.58)
公允價值變動(損失)/收益		<b>(290,235.43)</b>	210,236.11
信用減值損失		<b>(33,284,139.70)</b>	(45,676,282.02)
資產減值損失	10	<b>(439,276,256.74)</b>	(168,768,031.87)
資產處置收益		<b>533,425.33</b>	2,116,899.58
<b>營業利潤</b>		<b>204,017,242.82</b>	558,939,418.86
加：營業外收入		<b>40,477.28</b>	467,689.36
減：營業外支出		<b>1,710,497.81</b>	513,570.59
<b>利潤總額</b>		<b>202,347,222.29</b>	558,893,537.63
所得稅(費用)/抵免	11	<b>(679,015.69)</b>	865,377.50
<b>淨利潤</b>		<b>201,668,206.60</b>	559,758,915.13
<b>按經營持續性分類</b>			
持續經營淨利潤		<b>201,668,206.60</b>	559,758,915.13
<b>按所有權歸屬分類</b>			
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>232,337,565.04</b>	572,595,101.31
少數股東損益		<b>(30,669,358.44)</b>	(12,836,186.18)
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>17,134,690.26</b>	87,455.61
歸屬於母公司股東的其他綜合收益			
的稅後淨額		<b>17,134,690.26</b>	87,455.61
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動		<b>17,885,613.77</b>	(247,753.77)

將重分類進損益的其他綜合收益 外幣財務報表折算差額		<u>(750,923.51)</u>	<u>335,209.38</u>
<b>綜合收益總額</b>		<b><u>218,802,896.86</u></b>	<b><u>559,846,370.74</u></b>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額		<b>249,472,255.30</b>	572,682,556.92
歸屬於少數股東的綜合收益 總額		<b>(30,669,358.44)</b>	(12,836,186.18)
<b>每股收益</b>	12		
基本每股收益		<b><u>0.28</u></b>	<b><u>0.70</u></b>
稀釋每股收益		<b><u>0.28</u></b>	<b><u>0.70</u></b>

## 財務報表附註

截至 2025 年 12 月 31 日止年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

### 一. 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本財務報表包含聯交所證券上市規則規定的適用披露。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

### 二. 重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、內部開發項目支出資本化條件、收入確認和計量等。

#### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2025年12月31日的財務狀況以及2025年度的經營成果。

#### 2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3. 記帳本位幣

本公司記帳本位幣和編制本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬子公司及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記帳本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。

### 三. 產品和勞務資訊

#### 對外交易收入

	2025 年	2024年
安全與識別芯片	854,861,718.82	790,957,781.09
非揮發存儲器	1,041,530,821.63	1,135,832,442.81
智能電錶芯片	518,448,862.94	396,694,720.15
FPGA及其他產品	1,420,475,745.69	1,133,630,167.08
集成電路測試服務	143,874,135.24	130,163,015.77
租賃收入	3,069,817.20	2,945,701.33
	<u>3,982,261,101.52</u>	<u>3,590,223,828.23</u>

#### 地理資訊

#### 對外交易收入

	2025 年	2024年
中國大陸	3,797,884,188.58	3,388,010,913.84
其他	184,376,912.94	202,212,914.39
	<u>3,982,261,101.52</u>	<u>3,590,223,828.23</u>

#### 分部報告

#### 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下 2 個報告分部：

- 設計及銷售集成電路分部（“設計分部”）生產安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA 及其他產品；
- 集成電路測試服務分部（“測試分部”）包括集成電路芯片及集成電路產品測試服務。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

經營分部間的轉移定價，參照與第三方進行交易所採用的公允價格制定。

## 2025年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,836,022,020.63	146,239,080.89	-	3,982,261,101.52
分部間交易收入	-	170,019,147.68	(170,019,147.68)	-
採用權益法核算的投資 損失	5,564,320.89	-	-	5,564,320.89
資產減值損失	439,276,256.74	-	-	439,276,256.74
折舊和攤銷	223,444,763.15	172,811,018.15	(1,199,853.68)	395,055,927.62
利潤總額	269,095,941.63	(61,410,783.66)	(5,337,935.68)	202,347,222.29
所得稅費用	6,100,281.85	(5,507,888.98)	86,622.82	679,015.69
資產總額	8,014,447,763.86	1,312,626,425.91	(121,938,369.89)	9,205,135,819.88
負債總額	2,280,782,978.58	268,563,195.20	(98,393,107.71)	2,450,953,066.07
採用權益法核算的長期 股權投資	46,892,929.09	-	-	46,892,929.09
資本性支出(註)	165,371,273.51	186,451,790.35	-	351,823,063.86

## 2024年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,457,956,337.56	132,267,490.67	-	3,590,223,828.23
分部間交易收入	-	144,008,061.33	(144,008,061.33)	-
採用權益法核算的投資 損失	3,430,403.58	-	-	3,430,403.58
資產減值損失	168,768,031.87	-	-	168,768,031.87
折舊和攤銷	199,640,771.24	139,656,656.31	1,856,023.33	341,153,450.88
利潤總額	587,465,062.23	(23,028,412.98)	(5,543,111.62)	558,893,537.63
所得稅費用	7,122,318.51	(8,045,183.99)	57,487.98	(865,377.50)
資產總額	7,766,982,774.09	1,317,390,545.48	(43,260,520.48)	9,041,112,799.09
負債總額	2,322,543,877.35	217,708,519.43	(43,260,520.48)	2,496,991,876.30
採用權益法核算的長期 股權投資	54,181,165.60	-	-	54,181,165.60
資本性支出(註)	311,184,331.49	195,153,297.17	-	506,337,628.66

註：資本性支出包括固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、開發支出、長期待攤費用和其他非流動資產支出。

#### 四. 合併財務報表主要項目註釋

##### 1. 應收票據

	2025年	2024年
銀行承兌匯票	38,929,339.96	19,225,396.18
商業承兌匯票	<u>271,739,586.41</u>	<u>286,740,412.59</u>
	310,668,926.37	305,965,808.77
減：應收票據壞賬準備	<u>13,674,425.00</u>	<u>7,252,632.26</u>
	<u>296,994,501.37</u>	<u>298,713,176.51</u>

應收票據壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	年末餘額
2025年	7,252,632.26	6,421,792.74	-	13,674,425.00
2024年	7,590,502.77	-	337,870.51	7,252,632.26

##### 2. 應收賬款

應收賬款信用期通常為1個月至6個月。應收賬款並不計息。

按發票日期確認的應收賬款賬齡分析如下：

	2025年	2024年
1年以內	1,128,104,025.31	1,066,133,983.44
1年至2年	689,808,867.73	430,339,657.61
2年至3年	134,313,233.01	60,587,802.99
3年至4年	15,811,595.91	1,767,651.58
4年至5年	1,345,931.88	1,136,154.93
5年以上	<u>1,532,786.10</u>	<u>1,224,109.80</u>
	1,970,916,439.94	1,561,189,360.35
減：應收賬款壞賬準備	<u>94,017,259.05</u>	<u>67,383,714.11</u>
	<u>1,876,899,180.89</u>	<u>1,493,805,646.24</u>

	賬面餘額		2025年12月31日 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額
按信用風險特徵組合計提					
壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	1,791,149,721.64	90.88	83,463,849.05	4.66	1,707,685,872.59
工業品銷售款項組合	139,008,517.43	7.05	9,334,745.06	6.72	129,673,772.37
測試服務款項組合	40,758,200.87	2.07	1,218,664.94	2.99	39,539,535.93
	<u>1,970,916,439.94</u>	<u>100.00</u>	<u>94,017,259.05</u>	<u>4.77</u>	<u>1,876,899,180.89</u>

	賬面餘額		2024年12月31日 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額
按信用風險特徵組合計提					
壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	1,377,451,107.96	88.23	46,713,948.23	3.39	1,330,737,159.73
工業品銷售款項組合	136,176,470.73	8.72	19,209,800.93	14.11	116,966,669.80
測試服務款項組合	47,561,781.66	3.05	1,459,964.95	3.07	46,101,816.71
	<u>1,561,189,360.35</u>	<u>100.00</u>	<u>67,383,714.11</u>	<u>4.32</u>	<u>1,493,805,646.24</u>

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	外幣折算	本年收回 或轉回	本年核銷	年末餘額
2025年	67,383,714.11	26,862,346.96	-	-	(228,802.02)	94,017,259.05
2024年	23,813,666.81	46,014,152.53	-	-	(2,444,105.23)	67,383,714.11

### 3. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在3個月內清償。  
按發票日期確認的應付賬款賬齡分析如下：

	2025年	2024年
1年以內	181,687,801.95	205,214,678.96
1至2年	22,555,500.13	11,596,707.46
2年以上	28,961,192.70	17,810,126.29
	<u>233,204,494.78</u>	<u>234,621,512.71</u>

於2025年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款（2024年12月31日：無）。

#### 4. 股本

##### 2025 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	53,709,730.00	228,595.00	-	228,595.00	53,938,325.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>82,142,730.00</u>	<u>228,595.00</u>	<u>-</u>	<u>228,595.00</u>	<u>82,371,325.00</u>

於 2025 年 12 月 30 日，本公司向滿足 2021 年 A 股限制性股票激勵計畫首次授予部分第四個歸屬期以及預留授予部分第三個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司 A 股人民幣普通股股票，導致股本增加人民幣 228,595.00 元。

##### 2024 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	53,473,040.00	236,690.00	-	236,690.00	53,709,730.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>81,906,040.00</u>	<u>236,690.00</u>	<u>-</u>	<u>236,690.00</u>	<u>82,142,730.00</u>

#### 5. 未分配利潤

	2025年	2024年
年初未分配利潤	3,871,837,648.79	3,381,266,932.48
歸屬於母公司股東的淨利潤	232,337,565.04	572,595,101.31
減：提取法定盈餘公積	(114,297.50)	(118,345.00)
對所有者的分配	<u>(65,714,184.00)</u>	<u>(81,906,040.00)</u>
年末未分配利潤	<u>4,038,346,732.33</u>	<u>3,871,837,648.79</u>

## 6. 股息

於 2026 年 3 月 27 日，公司召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關於公司 2025 年度利潤分配預案的議案》。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股普通股派發現金紅利人民幣 0.58 元（含稅）（2024 年已派付：人民幣 0.80 元（含稅）），預計分配現金紅利總額為人民幣 47,775,368.50 元（2024 年已派付：人民幣 65,714,184 元），佔 2025 年度歸屬於母公司股東的淨利潤之比為 20.56%。

## 7. 營業收入及成本

	2025 年		2024 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,972,333,011.49	1,742,614,295.58	3,584,932,102.66	1,580,427,287.15
其他業務	9,928,090.03	2,192,767.72	5,291,725.57	1,173,652.82
	<u>3,982,261,101.52</u>	<u>1,744,807,063.30</u>	<u>3,590,223,828.23</u>	<u>1,581,600,939.97</u>

## 8. 稅金及附加

	2025年	2024年
城市維護建設稅	19,282,783.41	4,480,357.95
印花稅	2,736,387.39	2,612,420.49
房產稅	2,590,542.79	4,615,033.74
土地使用稅	61,249.68	29,184.70
教育費附加	26,557.49	23,975.94
地方教育附加	25,025.00	15,983.96
車船稅	-	6,720.00
	<u>24,722,545.76</u>	<u>11,783,676.78</u>

## 9. 研發費用

	2025年	2024年
職工薪酬	724,561,650.14	579,160,860.11
材料及加工費	223,355,115.39	194,882,743.21
折舊及攤銷	186,534,118.71	154,116,239.84
技術服務費	49,987,749.58	46,405,686.37
股權激勵費用	17,219,699.81	40,256,370.09
辦公費	8,400,227.57	7,851,863.42
差旅費	3,060,967.84	2,703,272.06
其他	9,622,594.44	5,274,486.62
	<u>1,222,742,123.48</u>	<u>1,030,651,521.72</u>

## 10. 資產減值損失

	2025年	2024年
存貨跌價損失	(419,977,115.07)	(168,590,656.26)
無形資產減值損失	(18,022,968.46)	(177,375.61)
長期股權投資減值損失	(1,276,173.21)	-
	<u>(439,276,256.74)</u>	<u>(168,768,031.87)</u>

## 11. 所得稅費用/(抵免)

	2025年	2024年
當期所得稅費用	6,071,135.42	7,155,998.73
遞延所得稅費用	(5,392,119.73)	(8,021,376.23)
	<u>679,015.69</u>	<u>(865,377.50)</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2025年	2024年
利潤總額	202,347,222.29	558,893,537.63
按適用稅率計算的所得稅費用	30,352,083.32	83,834,030.64
某些子公司適用不同稅率的影響	(159,029.62)	(2,176,153.98)
不可抵扣的費用	3,655,690.71	2,740,770.86
研發費加計扣除	(142,050,068.36)	(142,526,763.19)
利用以前年度可抵扣虧損	(2,218,661.49)	(309,012.29)
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和 可抵扣虧損	104,999,872.32	50,421,460.17
調整以前期間所得稅的影響	6,099,128.81	7,150,290.29
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>679,015.69</u>	<u>(865,377.50)</u>

## 12. 每股收益

	2025年 元/股	2024年 元/股
基本每股收益		
持續經營	<u>0.28</u>	<u>0.70</u>
稀釋每股收益		
持續經營	<u>0.28</u>	<u>0.70</u>

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	2025年	2024年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期 淨利潤 持續經營	<u>232,337,565.04</u>	<u>572,595,101.31</u>
	2025年	2024年
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	823,713,250.00	819,202,673.00
稀釋效應—普通股的加權平均數 股份期權	<u>3,949.00</u>	<u>3,415,660.00</u>
調整後本公司發行在外普通股的加權 平均數	<u>823,717,199.00</u>	<u>822,618,333.00</u>

## 管理層討論與分析

### 一、 經營情況討論與分析

截至 2025 年 12 月 31 日止年度（「報告期」），全球宏觀經濟有所復蘇，半導體行業景氣度上行，下游需求出現分化。以消費、中低端物聯網為下游的部分芯片市場需求承壓，而本公司積極開拓汽車電子、工控、智慧家電等領域下游客戶，相關芯片產品銷量實現快速增長；FPGA 和部分應用於高可靠場景的非揮發存儲器仍然保持技術領先性，新品持續放量，客戶需求穩定增長。同時 FPGA 系列產品在多個領域持續拓展，高價值產品成爲主要增長引擎，營收實現較快增長。

2025 年本公司實現營業收入約人民幣 39.82 億元，同比增長 10.92%，綜合毛利率 56.19%，歸屬於上市公司股東淨利潤約人民幣 2.32 億元。現就 2025 年度經營情況報告如下：

#### （一） 各產品線的業務情況

本集團是國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，主要有現場可編程門陣列（FPGA）、安全與識別、非揮發存儲器、智能電錶芯片四大類產品線，並通過控股子公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司（「華嶺股份」）為客戶提供芯片測試服務。

##### 1、 FPGA 及其他產品產品線

該產品線擁有現場可編程門陣列芯片（FPGA）、嵌入式可編程器件芯片（PSoC）、可編程人工智能芯片（FPAI）共三個子系列產品，並提供專用 EDA 開發工具。本公司是國內領先的 FPGA 類產品供應商，2025 年 FPGA 及其他產品實現銷售收入約人民幣 14.20 億元。

報告期內，產品線堅持高質量的產品和服務標準，構建“芯片-軟件-解決方案”的生態體系。產品線以億門級 FPGA 和 PSoC 芯片作爲主力產品，廣泛應用於工業控制、測試測量、電力能源、消費電子、音視頻、人工智能、衛星通信以及高可靠等領域。FPGA 子系列產品維持了較好的增長態勢，銷售額穩健增長；PSoC 子系列產品受益於下游市場需求增加，銷售額大幅增長；FPAI 子系列產品譜系產品拓展良好，積極推廣和導入相關領域新用戶。

FPGA 產品線積極推進基於 1x nm FinFET 先進制程、2.5D 先進封裝的超大規模的高端 FPGA 產品的開發和產品化工作，強化技術壁壘，構建多元產品矩陣，布局包括 FPGA、RF-FPGA、PSoC、RFSoc 以及 FPAI 等多種產品類型，完成邏輯資源從 50K 至 4000K，算力從 4TOPS 至 128TOPS 譜系產品開發，新產品導入客戶順利，產品應用領域和客戶規模快速增長，市場的廣泛認可驅動銷量快速增長，產品在關鍵領域的滲透率與影響力顯著提升。

## 2、安全與識別產品線

該產品線擁有射頻識別（RFID）與傳感芯片、智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2025 年實現銷售收入約人民幣 8.55 億元。

射頻識別（RFID）與傳感芯片，包含高頻與超高頻 RFID 芯片，以及傳感器芯片。高頻 RFID 廣泛應用於各類物聯網設備，本公司產品競爭力持續提升，持續保持較高的市佔率，其中 NFC 通道/標籤芯片保持持續創新，在消費電子、工業、汽車等領域出貨量領先；超高頻 RFID 主要應用於鞋服管理、商超、航空行李標等領域，本公司積極拓展市場，取得了較好的成果。

智能卡與安全芯片，智能卡市場整體進入成熟期，市場規模維持穩定，國內競爭較為激烈，本公司市場份額維持穩定。隨著物聯網的發展，安全需求逐漸增加，對於安全芯片的需求持續提升，本公司積極拓展各類細分市場，取得了較好的成績，本公司是首家獲得 WPC 認證的國內安全芯片供應商，無線充安全模塊的銷售量逐步攀升，在消費類、車載、工業等領域廣泛出貨。

智能識別設備芯片，NFC 讀寫器廣泛應用於移動支付、公共交通、智能門禁、智能家居等領域。隨著數字經濟的持續發展和物聯網的不斷推進，NFC 技術的應用場景有望進一步拓展。本公司 NFC 產品廣泛應用於金融 POS、智能門鎖和門禁等市場，在推進擴大市佔率的同時，產品線積極拓展高價值應用，產品競爭力明顯，得到客戶高度認可。

## 3、非揮發存儲器產品線

該產品線擁有電可擦除可編程只讀存儲器（EEPROM）、NOR 型閃存存儲器（NOR Flash）和 SLC NAND 型閃存存儲器（NAND Flash）等各類存儲器產品，具有多種容量、接口和封裝形式。2025 年實現銷售收入約 10.42 億元，其中，高可靠存儲器實現銷售收入約人民幣 6.81 億元。

報告期內，EEPROM 產品在電錶、手機攝像頭模組、家電等領域穩步增長，車規級 EEPROM 產品已實現批量出貨，成功進入部分車企 AVL 名單；NOR Flash 產品在顯示屏、晶圓合封、安防監控三大核心領域銷售有所下滑，在工控醫療和 PC 市場拓展順利，低壓新品系列陸續在顯示屏、PC 領域完成客戶導入；NAND Flash 芯片在下游應用設備中存儲容量不斷增大，產品線在網通、安防監控、可穿戴領域持續重點布局，產品在主要客戶中獲得批量應用。高可靠存儲器銷量穩步增長，是本公司非揮發存儲器產品線的重要構成。

## 4、智能電錶芯片產品線

本集團智能電錶產品線涵蓋智能電錶 MCU、通用 MCU 產品及車規 MCU 產品。智能電錶 MCU 是智能電錶的核心元器件，可實現工業和家庭用戶的用電信息計量、自動抄讀、信息傳輸等功能；通用 MCU 產品廣泛應

用於智能水氣熱表、智慧家電、工業等領域；車規 MCU 產品可應用於車身控制及舒適系統。2025 年實現銷售收入約人民幣 5.18 億元。

報告期內，本公司該產品綫營業收入維持快速增長態勢。受智能電錶替換周期影響，2025 年國網、南網電錶招標均有下降，但智能電錶 MCU 的銷售額仍然實現穩健增長，主要原因是本公司在智能電錶單相 MCU 領域繼續保持領先地位，積極配合客戶端完成國網、南網新規範方案研討、開發、磨合工作，市場佔有率持續領先。通用 MCU 產品及車規 MCU 產品方面，本公司在汽車電子、智慧家電、工控等領域出貨量均實現快速增長，其中在汽車電子領域年銷量已超過 2000 萬顆，較上年度有顯著增長。

## 5、 其他業務

### (1) 其他產品

其他產品主要是智能電器芯片，在漏電保護裝置、新能源電動汽車充電樁、光伏以及防止電氣火災等新能源領域有良好應用。報告期內，傳統漏電保護市場受房地產低迷影響，銷售額有所下降；在新能源、電動汽車充電樁領域，漏電保護市場空間持續增長；故障電弧保護芯片獲得海外頭部客戶認可，銷量快速增長。

### (2) 華嶺股份測試服務業務

華嶺股份作為公司的控股子公司，是國內較早涉足集成電路測試技術研發與專業服務的公司。其在高端產品測試解決方案、量產自動化、測試信息化等領域積累了豐富的技術經驗，在技術創新方面取得了顯著成果，承擔了多項國家科技重大專項和省部級科研項目，自主研發超 1,000 種高端芯片測試解決方案，在高速晶圓 KGD 測試、超高密度晶圓測試等方向實現量產突破。此外，本公司還在人工智能芯片、高性能計算芯片、車規芯片測試方案和成套工程技術等領域持續進行研發與創新應用。

### (3) 復微迅捷業務

上海復微迅捷數字科技股份有限公司（「復微迅捷」）以 NFC 技術和雲服務為業務支點，努力做出特色業務。報告期內，復微迅捷通過與主要互聯網平臺合作，賦能支持公共交通行業提升消費體驗；與世界頭部 IP 廠商合作，推出交通卡行業兼具文創特色的產品，積極參與谷子經濟；在汽車行業實現車規級 IC 卡車鑰匙批量供貨。同時，通過短距離通信測試實驗室為車企、手機廠商、芯片廠商提供專業測試服務；升級實體卡應用場景，在全國大學校園卡、門禁等領域持續推廣手機 NFC 應用。

## (二) 研發投入與人才隊伍建設

報告期內，本集團高度重視研發，全年研發投入約人民幣 10.7 億元，佔收入的比例為 26.88%；本集團研發人員為 993 人。本集團正在同步推進包括但不限於新一代 FPGA 平台開發及產業化項目、智能化可重構 SoC 平台開發及產業化項目、新工藝平台存儲器開發及產業化項目、新型高端安全控制器開發及產業化項目和無源物聯網基礎芯片開發及產業化項目，目前推進中。

## (三) 核心技術與研發進展

### (1) FPGA 芯片

本公司是國內領先的 FPGA 類產品供應商。本公司 FPGA 產品綫已成功突破了超大規模 FPGA 架構、可編程器件編譯器、多協議超高速串行收發器、異構智算架構、高可靠可編程器件、超大規模可編程器件配套全流程 EDA 等關鍵技術，在 FPGA 和 PSoC 產品形成了明顯的技術集群優勢，構建了核心技術壁壘，夯實了競爭優勢。本公司目前已可提供 1xnm FPGA 產品、RF-FPGA 產品、PSoC 產品、RFSoc 產品以及 FPAI 產品，具備全流程自主知識產權的配套 EDA 工具。本公司已形成豐富的 FPGA 和 PSoC 產品譜系，系列產品已在通信領域、工業控制領域及高可靠領域獲得廣泛應用。本公司擁有目前國內規模最大的 FPGA 產品。此外，本公司是 RF-FPGA 單片架構的首創單位，也是目前國內該類產品的主要供貨商。

本公司 FPAI 異構融合架構芯片，集 SoC、FPGA、NPU 於一體，為公司面向定制化邊緣、融合端推理應用的可重構智能芯片，本公司已構建該異構融合智能芯片的芯片設計平台及應用開發軟件平台，已佈局 4TOPS 至 128TOPS 的譜系化產品，首顆 32TOPS 算力芯片推廣進展良好，8TOPS 和 128TOPS 算力芯片分別完成流片和測試，準備產品化。本公司是 FPAI 架構的首創單位，也是目前國內該類產品的唯一供貨商。

報告期內，本公司分別完成了一款 1xnm FPGA、一款 1xnm RF-FPGA、一款 1xnm RFSoc 芯片的流片、測試和可靠性驗證工作，目前正積極推進客戶端導入；本公司完成了兩款 FPAI 產品的流片和測試工作，正在進行可靠性驗證，儘快進行市場推廣和客戶端導入；此外，本公司規劃了新款 1xnm RF-FPGA 和 1xnm RFSoc 芯片，已完成設計進行流片。報告期內，本公司憑藉領先的技術成果和市場影響力，獲得 2025 年“上海市製造業單項冠軍企業”稱號。

### (2) 安全與識別芯片

安全與識別產品綫經過多年的持續研發和技術積累，在射頻和安全兩大關鍵技術領域形成了較為明顯的技術和研發優勢。基於多年的射頻芯片設計技術積累，進一步研究形成新一代 NFC 技術，以支持更多種類的 NFC 設備。同時在超高頻 RFID 標籤芯片和讀寫器芯片產品方面取得技術突破，在高靈敏度設計、低功耗設計、高可靠性設計等方面取得技術積累。

報告期內，本公司成功推出超高頻 FM13UF 系列標籤芯片，具備高靈敏度、超可靠、快速數據寫入和讀取功能，同時也推出了超高頻讀寫器芯片，兩者配套使用更可有效提升標籤盤點成功率，顯著拓展標籤識讀距離。NFC 通道/標籤系列產品廣泛應用於電子價簽，LED 照明，智能家居，“一碰連/付”等應用場景，良好的手機兼容性和可靠的性能得到了客戶的一致好評。NFC 讀寫器芯片系列成功應用於汽車數字鑰匙、車內啓動、車載無線充和車載香氛領域，為汽車主機廠和 Tier1 客戶提供高性价比的車規級解決方案。

(3) 非揮發存儲器

本公司非揮發存儲器產品綫擁有業界較全面的產品佈局，持續聚焦性能和可靠性提升、拓展應用、成本優化的目標，堅持關鍵技術突破、多器件工藝平台協同發展和產品升級，核心領域取得顯著進展。

報告期內，EEPROM 產品突破車規級寬溫、超寬電壓、低功耗技術瓶頸，在數據擦寫壽命、數據保持時間、產品魯棒性等關鍵特性達到業界領先水平，完成多款中小容量產品迭代，多款中大容量產品通過 AEC-Q100 Grade1 認證，成功導入部分 Tier 1 及整車廠供應鏈，適用於 DDR5 的 SPD5 Hub 產品已實現量產；NOR 產品持續推進工藝節點下探，4xnm 平台研發持續推進；ETOX 5xnm 低壓高性能低功耗系列化產品批力量產，同系列車規考核順利推進；NORD 工藝平台產品開發按期進展；SLC NAND 2xnm 新制程產品已成功實現量產，國內供應鏈 2xnm 平台系列新產品驗證優化中，滿足客戶供應鏈安全需求。

(4) 智能電錶芯片

報告期內，本公司 MCU 產品綫積極佈局全國產化供應鏈，完成了基於國產 eflash 工藝平台的多款產品研發，目標市場覆蓋公用事業、白色家電、汽車電子、工業控制領域，實現了 12 寸和 8 寸工藝平台的完整佈局，進一步豐富產品陣容，並積極推進客戶導入與量產工作。產品綫圍繞行業應用構建超低功耗技術平台、高可靠車規技術平台，在深挖行業應用的基礎上積極拓展技術與產品覆蓋面；在不斷豐富 32 位 MCU 產品組合的同時，也推出多款中高性能 MCU 產品，並且面向計量、觸摸、汽車高壓全集成應用等特定應用場景推出多種特色集成化 MCU 產品。其中應用於公用事業的低功耗 MCU 持續保持行業領先的市場份額，白色家電主控和車規 MCU 出貨量快速增長，銷量同比增長超 100%。

(四) 風險因素

(1) 業績大幅下滑或虧損的風險

本公司 2025 年營業收入實現增長，但因計提存貨跌價損失，以及對部分資本化的研發項目支出進行撇銷處理等因素，歸屬於母公司所有者的淨利潤下滑。

2026 年度，本公司為應對供應鏈風險和提升公司產品競爭力，仍需在供應鏈建設、研發方面進行投入。若未來市場需求不及預期、行業競爭格局惡化，本公司營收變動情況與投入存在節奏差異，將可能導致當期的公司業績下滑。

(2) 核心競爭力風險

1、新產品研發及技術迭代風險

本公司所處的集成電路設計行業為典型的技術密集型行業，技術的升級與產品的迭代速度快，同時芯片產品擁有較高的技術壁壘且先發企業的優勢明顯。如果本公司在後續研發過程中對市場需求判斷失誤或研發進度緩慢，將面臨被競爭對手搶佔市場份額的風險。此外，高端芯片研發存在開發周期長、資金投入大、研發風險高的特點，在研發過程中很可能存在因某些關鍵技術未能突破或者產品性能、參數、良率等無法滿足市場需要而研發失敗、落後於新一代技術的風險。

2、吸引人才風險

目前國內芯片設計行業發展迅速，企業間對研發人才的競爭十分激烈。本公司需要制訂出良好的人才激勵政策，持續提升人力資源管理能力以適應快速發展的需要，否則可能面臨核心人才流失的風險，同時也可能陷入難以吸引優秀人才加盟的境地，從而導致本公司無法保持持續的創新能力。

(3) 經營風險

產品銷售價格及毛利率下降的風險。國際方面，本公司與同行業龍頭企業相比，本公司某些產品在產品布局的豐富程度、工藝制程與性能表現等技術指標的先進程度、經營規模或市場佔有率的領先程度上存在差距；在國內方面，集成電路設計行業受到社會、市場和資本的關注度不斷提高，本公司各條產品綫所面對的競爭對手也在逐漸增多，競爭加劇。

近年來，部分芯片產品供求關係已經發生變化，行業整體的毛利率水平受到明顯衝擊；同時，本公司現有的高可靠成熟產品受市場競爭以及新拓展領域毛利率水平較低等因素影響，其毛利率水平也有一定的下調。

若未來因技術水平進步、人工和原材料價格上漲以及本公司產品議價能力下降，而本公司不能採取有效措施以鞏固和增強產品競爭力，本公司綜合毛利率也將面臨持續下降的風險，進而造成本公司在激烈的市場競爭中處於不利地位，降低持續盈利能力。

(4) 財務風險

1、存貨跌價風險

本公司存貨主要為芯片及晶圓，為保障供應鏈安全，本公司投入了較大的資源。報告期期末，本公司存貨賬面價值約為人民幣 263,659.43 萬元，佔對應期末流動資產總額的 38.44%。本公司每年根據存貨的可變現淨值低於成本的金額計提相應的跌價準備。報

告期期末，本公司存貨跌價準備餘額約為人民幣 79,602.69 萬元，存貨跌價準備計提的比例為 23.19%。若未來市場加速下行，或者由於技術迭代導致產品更新換代加快，可能導致存貨跌價風險提高，從而對本公司經營業績產生不利影響。

## 2、研發投入相關的財務風險

本公司高度重視核心技術的自主研發，報告期內研發投入約為人民幣 10.70 億元，佔報告期內營業收入的 26.88%，研發投入強度較高。若開發支出形成的無形資產計提攤銷，或開發支出出現撤銷、無形資產出現減值等情形，可能將對本公司的利潤產生較大影響。

## 3、政府補助、稅收優惠等政策變動的風險

本公司所從事的集成電路設計及集成電路測試相關業務受到國家產業政策的鼓勵和支持。本公司擁有較強的科研實力，報告期內取得了較多的科研項目經費補貼，能夠在一定程度上彌補本公司的研發投入。本公司作為高新技術企業和集成電路設計企業，享受優惠稅收政策支持。如果國家鼓勵政策發生變化，可能造成本公司盈利水平波動的風險。

## 4、應收賬款及應收票據回收的風險

報告期末，本公司應收賬款賬面餘額約為人民幣 197,091.64 萬元，應收票據賬面餘額約為人民幣 31,066.89 萬元。應收賬款與應收票據賬面餘額合計佔營業收入的比例為 57.29%。如果未來宏觀經濟形勢、行業發展前景等因素發生不利變化，客戶經營狀況發生重大困難，本公司可能面臨應收賬款及應收票據無法收回而增加壞賬損失的風險。

## (5) 行業風險

### 1、行業景氣度發生變動的風險

本報告期，由於芯片供求變化，行業競爭加劇，對本公司毛利率水平帶來挑戰。雖然本公司產品綫覆蓋範圍包括工業級產品、消費、高可靠等應用場景，抗波動能力較強，但如果出現行業性的增長放緩或持續性不景氣，仍然可能對本公司業績造成不利影響。

### 2、供應鏈調整或變動的風險

當前全球半導體行業貿易管制與技術限制持續升級，國內芯片設計企業面臨海外供應鏈體系調整的外部壓力，核心原材料、核心設計工具及製造環節的海外供應渠道存在不確定性，企業需推進供應鏈多元化重構，在此過程中將面臨供應鏈切換成本增加、核心環節適配周期拉長等經營挑戰。同時，受外部管制政策影響，部分境內外客戶出於供應鏈穩定性及合規性考量，存在合作意向調整、訂單轉移的可能性，可能導致企業面臨客戶流失、市場拓展受阻的市場風險，進而對企業經營業績、市場份額及行業競爭力產生一定不利影響。

(6) 宏觀環境風險

近年來國際貿易環境不確定性增加，逆全球化貿易主義進一步蔓延，部分國家採取貿易保護政策，屢屢採取長臂管轄措施，對我國集成電路產業有所衝擊。集成電路行業具有典型的全球化分工合作特點，若國際貿易環境發生重大不利變化、各國與各地區間貿易摩擦進一步升級、全球貿易保護主義持續升溫，則可能對包括本公司在內的集成電路產業鏈上下游公司的生產經營產生不利影響，造成產業鏈上下游交易成本增加或影響本公司供應鏈安全，從而對本公司的經營帶來不利影響。

## 二、 報告期內集團所從事的主要業務、主要產品或服務情況

### 1、 主要業務

本集團從事超大規模集成電路的設計、開發、測試，並為客戶提供系統解決方案。本集團目前已建立健全 FPGA 芯片、安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片和集成電路測試服務等產品線，產品廣泛應用於金融、社保、防偽溯源、網路通訊、家電設備、汽車電子、工業控制、信號處理、數據中心、人工智能、衛星通信等眾多領域。

### 2、 主要產品及服務情況

#### 2.1 FPGA 芯片

FPGA 是一種硬件可重構的集成電路芯片。FPGA 擁有軟件的可編程性和靈活性，在 5G 通信、人工智能等迭代升級週期較頻繁、技術不確定性較大的領域，FPGA 是較為理想的解決方案。本公司是國內領先的 FPGA 類產品供應商。

本公司各系列 FPGA 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
FPGA 芯片	本公司擁有包括 1xnm FinFET 先進制程 成熟制程在內的 SRAM 型 FPGA 芯片多元產品矩陣，邏輯資源從 50K 到 4000K，高速串行接口速率最高可達 32Gbps	適用於 5G 通信、人工智能、數據中心、計算機視覺、機器學習、高速數字處理、測試測量、工業控制、高可靠等高性能、智能座艙、視頻監控、醫學影像、網絡通信、網絡安全等行業領域，提供高性能、大帶寬的應用

RF-FPGA 芯片	本公司擁有 1xnm FinFET 先進制程的射頻可編程芯片產品矩陣，RFADC 採樣率達 5Gbps	適用於智能通信、測試測量、高可靠等行業領域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性產品。
PSoC 芯片	本公司擁有包括 1xnm FinFET 先進制程成熟制程在內的可編程融合芯片產品矩陣，單芯片集成了基於具有豐富特點的四核處理器的處理系統和可編程邏輯。	適用於音視頻、工控、安全、高可靠等行業領域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性產品。
RFSoc 芯片	本公司擁有 1xnm FinFET 先進制程的射頻可編程融合芯片產品矩陣，主要包含 FMZQ 系列寬帶可重構軟件無線電一體化芯片，單芯片集成四核高性能 SoC、可編程邏輯 FPGA、寬帶射頻直採高速 ADC/DAC 等。	適用於測試測量、工業控制、高可靠、衛星通信等行業領域，提供高性能、高集成度、高安全性、高可靠性產品。
FPAI 芯片	本公司擁有包括 1xnm FinFET 先進制程成熟制程的可編程人工智能芯片產品矩陣，主要包括 FMZQAI 系列產品，單芯片集成了基於四核處理器的處理系統、可編程邏輯和 AI 加速模塊，AI 加速引擎支持加速卷積神經網絡前向推理計算，包含 MAC 計算單元和內部存儲硬核部分，配合 AI 加速軟核完成調度。	適用於邊緣端人工智能應用，提供 FPGA+SoC+NPU 架構及全套邊緣端人工智能解決方案。

## 2.2 安全與識別芯片

本集團的安全與識別產品線依託自主研發的射頻、存儲器和安全防攻擊技術，已形成了射頻識別(RFID)與傳感芯片、智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個產品系列。產品覆蓋存儲卡、高頻/超高頻標籤、NFC TAG、接觸式/非接觸式/雙介面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接觸讀寫器機具以及移動支付等數十款產品，是國內安全與識別芯片產品門類較為齊全的供應商之一。

本集團安全與識別產品線介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
射頻識別(RFID)與傳感芯片系列	主要由 FM11、FM13、FM44 系列產品構成，包括非接觸邏輯加密芯片、NFC 標籤和通道芯片、高頻 RFID 芯片、超高頻 RFID 標籤芯片和讀寫器芯片、傳感芯片等	身份鑒別、電子貨架、智能家居電器、物流管理、防偽溯源、車輛管理等
智能卡與安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列產品構成，包括非接觸式 CPU 卡芯片、雙介面 CPU 卡芯片、安全芯片	銀行、社保、電子證件、交通、校園、健康、電信、防偽等
智能識別設備芯片系列	主要由 FM17 系列構成，產品類型為非接觸讀寫器芯片	門鎖、門禁、非接觸讀卡器、OBU、金融 POS、地鐵閘機、智能家居、電動自行車等

## 2.3 非揮發存儲器

本集團的存儲芯片產品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價比的非揮發存儲器產品，目前主要產品為 EEPROM 存儲器、NOR Flash 存儲器和 SLC NAND Flash 存儲器，具有多種容量、接口和封裝形式，整體市場份額居國內前列。

本集團各非揮發存儲器產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
EEPROM 存儲器	主要由 FM24 /FM25 /FM93/FMSPD5118 系列構成，支援 I <sup>2</sup> C、I <sup>3</sup> C、SPI 及 Micro Wire 接口，存儲容量覆蓋 1Kbit-2Mbit。	手機模組、智能電錶、通訊、家電、顯示器、液晶面板、汽車電子、電腦內存條、醫療儀器、工控儀錶、密碼鎖等

NOR Flash 存儲器	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、通用並行接口，存儲容量 1Mbit-2Gbit	網路通訊、物聯網模組、電腦及周邊產品、手機模組、顯示器及屏模組、智能電錶、安防監控、機頂盒、Ukey、汽車電子、醫療儀器、工控儀錶、wifi/藍牙模組、高可靠應用等
SLC NAND Flash 存儲器	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、ONFI 平行接口，存儲容量 1Gbit-8Gbit	網路通訊、安防監控、可穿戴設備、機頂盒、汽車電子、醫療儀器等

## 2.4 智能電錶芯片

智能電錶 MCU 是智能電錶的核心元器件，可實現工業和家庭用電戶的用電信息計量、自動抄讀、信息傳輸等功能；通用 MCU 產品可應用於智能水氣熱表、智慧家電、工業控制等眾多領域；車規 MCU 產品可應用於車身控制及舒適系統。

本集團各系列 MCU 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
智能電錶 MCU	主要由 FM33A0xx 系列產品構成，產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 內核的智能電錶 MCU 及 SoC 芯片	國網單/三相智能電能表、南網單/三相智能電能表、海外單/三相智能電能表等
低功耗通用 MCU	主要由 FM33LC0xx、FM33LOxxD、FM33LG0xx、FM33LE0xx、FM33FR0xx、FM33LF0xx、FM33LR0xx、FM33FH0xx、FM33LH0xx、FM33FK5xx、FM33LD5xx、FM33FC5xx 等系列 MCU 產品構成，產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 內核的低功耗 MCU 芯片	智能水氣熱表、智慧家電、工業控制等

車規 MCU	主要由 FM33LG0xxA、 FM33LE0xxA、 FM33FT0xxA、 FM33FG0xxA、 FM33LF0xxA、 FM33HT0xxA、 FM33CT0xxA、 FM33FG5xxA 等系列 車規 MCU 產品構成， 產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0\ARM China-star 內核的 車規 MCU 芯片	車身控制及舒適系統等
--------	--	------------

## 2.5 集成電路測試服務

本公司控股子公司華嶺股份是一家獨立的專業集成電路測試企業，致力於為各類集成電路企業提供優質、經濟和高效的測試整體解決方案及多種增值服務。主要業務包括：測試技術研究、測試軟硬件開發、測試裝備研製、測試驗證分析、晶圓測試、成品測試、可靠性試驗、自有設備租賃等。

華嶺股份能夠為客戶提供從芯片驗證分析、晶圓測試到成品測試的集成電路測試服務整體解決方案。測試能力廣泛覆蓋處理器、5G 通訊、人工智能、無線連接、存儲器、車規級 MCU、模擬芯片等眾多產品領域。

## 三、經營成果分析

報告期內，本集團實現營業收入約人民幣 39.82 億元，同比增長 10.92%，歸屬於上市公司股東淨利潤約人民幣 2.32 億元，較上年同期減少 59.42%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為人民幣 1.42 億元，較上年同期減少 69.30%。

截止 2025 年 12 月 31 日，本集團總資產約為人民幣 92.05 億元，同比增長 1.81%；歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣 61.35 億元，同比增長 4.08%。

上述主要會計資料及財務指標的改變，主要由於以下因素引起：

### (1) 收入和毛利對淨利潤影響

2025 年，半導體行業的景氣度呈現出明顯的結構性分化，下游應用需求差異顯著。FPGA 產品在有線無線通信、衛星通信、工業控制、人工智能以及高可靠等領域應用良好，本公司產品競爭力強，營收增長；安全與識別芯片各子綫產品市場表現不同，在 RFID 與傳感芯片帶動下整體營收小幅增長；非揮發存儲器市場競爭激烈，全年營收下降；MCU 芯片因良好市場佈局和穩定產品質量，在車規和白色家電市場出貨較上年快速增長。本公司整體營業收入實現增長，毛利率保持穩定，毛利較上年同期增加約為人民幣 2.29 億元。

(2) 費用支出對淨利潤的影響

研發費用增加。為提高產品競爭力和供應鏈韌性，本公司持續加強多元供應體系建設，加大新工藝、新產品開發力度；同時受國際貿易環境變化影響，供應鏈及客戶需求發生變動，部分資本化的研發項目未來難以達成預期經濟效益，對部分開發支出進行撤銷處理。報告期內，研發費用約為人民幣 12.23 億元，較上年同期增加約為人民幣 1.92 億元。

資產減值損失增加。在國際環境不確定性增加、集成電路供應鏈頻繁波動背景下，為確保對客戶持續穩定交付，本公司近年實施戰略備貨策略，尤其加大了受限於境外產能的關鍵物料庫存。一方面，在國際貿易形勢緊張情況下，庫存有效提升了供應鏈安全與韌性，支撐相關產品市場良好表現，確保營業收入穩定；另一方面，部分備貨產品下游需求結構變化，銷售未達預期，當期計提存貨跌價損失增加。同時，部分無形資產項目因未達到預期收益計提了減值損失。報告期內，資產減值損失約為人民幣 4.39 億元，較上年同期增加約為人民幣 2.71 億元。

其他收益減少。本公司所確認的集成電路設計企業增值稅加計抵減額以及研發專項政府補助減少，導致其他收益減少。報告期內，其他收益約為人民幣 1.43 億元，較上年同期減少約為人民幣 0.91 億元。

- 營業收入變動原因說明： 主要系報告期內本公司的安全與識別芯片、智能電錶芯片及 FPGA 銷售額增加所致。
- 營業成本變動原因說明： 主要系報告期內營業收入增加，使得營業成本相應增加。
- 管理費用變動原因說明： 主要系報告期內本公司員工離職補償金增加所致。
- 財務費用變動原因說明： 主要系報告期內因美元匯率變動使得匯兌損失增加。
- 研發費用變動原因說明： 主要系報告期內部分資本化的研發項目未來難以達成預期經濟效益，將其撤銷計入研發費用。同時，持續保持了較強的研發投入，進行產品迭代和產品譜系化擴展，並且加強基於多元化供方工藝的產品研發所致。

其他收益變動原因說明：	主要系報告期內享受集成電路企業增值稅加計抵減稅收優惠收益及研發專項政府補助減少所致。
資產減值損失變動原因說明：	主要系報告期內部分備貨產品下游需求結構變化，銷售未達預期，當期計提存貨跌價損失增加。同時，部分無形資產項目因未達到預期收益計提了減值損失增加。
經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：	主要系本公司銷售商品收到的現金增加額所致。
投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：	主要系報告期內本公司購建固定資產、無形資產支付現金減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：	主要系本公司取得借款收到現金減少。同時，償還銀行貸款支付現金增加所致。
應收賬款變動原因說明：	主要系高可靠產品客戶貨款結算周期較長以及銷售增長致應收賬款增加。
預付款項變動原因說明：	主要系日常生產經營需要，預付供應商採購物料增加。
存貨變動原因說明：	主要系本公司產品銷售增加，使得存貨餘額下降。同時，計提存貨跌價準備增加，使得存貨賬面價值下降。
無形資產變動原因說明：	主要系本公司部分資本化項目達到預定可使用狀態轉為無形資產所致。
開發支出變動原因說明：	主要系本公司部分項目達到預定可使用狀態轉出。同時，將未來難以達成預期經濟效益的項目撤銷所致。
短期借款變動原因說明：	主要系公司調整債務結構，減少短期貸款，增加長期借款所致。
應付職工薪酬變動原因說明：	主要系年末計提年終獎金較上期增加所致。
一年內到期的非流動負債變動原因說明：	主要系一年內到期的長期借款減少所致。

長期借款變動原因說明： 主要系公司調整債務結構，減少短期貸款，增加長期借款所致。

### 產銷量情況分析表

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量 比上年 增減(%)	銷售量 比上年 增減(%)	庫存量 比上年 增減(%)
安全與識別芯片	萬顆	334,659.62	331,469.80	19,709.38	30.86	32.88	9.41
非揮發性存儲器	萬顆	92,326.36	92,687.95	19,844.25	10.11	10.61	-6.04
智能電錶芯片	萬顆	20,171.96	18,662.94	3,866.60	35.33	38.43	34.18
FPGA 及其他產品	萬顆	4,853.64	6,289.44	1,749.05	-46.16	-20.92	-45.06

#### 產銷量情況說明

- 1、安全與識別芯片銷售量增加主要由 RFID 與傳感芯片貢獻，本公司在該領域產品競爭力較強，持續推出新品，市場份額增加，產量和銷量增長。
- 2、智能電錶芯片銷售量增加主要系本公司產品應用領域不斷拓展，市場份額增加，生產量及庫存量同比增加。
- 3、FPGA 及其他芯片產銷量同比下降，主要系智能電器芯片下游市場需求下降，銷量下降，以及為消化庫存，本公司減少生產量，導致庫存量下降。

#### 重大投資及附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售

本集團於年內並無其他重大投資及附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售（2024 年：無）。

#### 財務資源及流動資金

於 2025 年 12 月 31 日，本集團之淨資產為人民幣 6,754,182,753.81 元（2024 年：人民幣 6,544,120,922.79 元），比往年增加約 3.21%。其中流動資產為人民幣 6,859,496,080.33 元（2024 年：人民幣 6,480,978,592.52 元），比往年增加約 5.84%，當中包括貨幣資金為人民幣 1,298,621,710.02 元（2024 年：人民幣 1,087,494,485.36 元），比往年增加約 19.41%。

本集團過往連年錄得盈利，故一直以盈利、發行股份、獲取銀行借款及內部產生的現金流量應付營運資金及業務發展需求。本集團一直採取謹慎之資金政策，故現時流動資金充裕，足以應付日常業務營運及未來發展所需。如未來本集團因業務發展而需要額外資金，亦會根據資金需求之規模及期間，向金融機構取得合適的授信，包括並不限於銀行借款、承兌匯票、票據貼現、貿易融資及信用証等。本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，亦無外幣投資淨額以貨幣借貸及／或其他對沖工具進行對沖。

由於本集團大部分業務均在中國營運，彼等進行的大部分交易均以人民幣計值及結算，故本集團所承受的貨幣匯率風險比較低。本集團並無訂立任何外匯對沖安排。董事認為，匯率波動對本集團的財務表現並無重大影響。

於 2025 年 12 月 31 日，本集團有銀行借款人民幣 1,475,521,935.85 元，需於 1 年內至 7 年內償還，年利率為 2.10%至 2.66%（2024 年：人民幣 1,665,513,184.63 元）。

### 股本變動

於 2025 年 12 月 30 日，本公司向滿足 2021 年 A 股限制性股票激勵計畫首次授予部分第四個歸屬期以及預留授予部分第三個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司 2,291,950 股 A 股人民幣普通股股票，其中 2,285,950 股於 2026 年 1 月 19 日上市流通，導致股本增加人民幣 228,595 元。發行完成後總股份數目為 823,713,250 股（其中 A 股 539,383,250 股，H 股 284,330,000 股）。另有剩餘 6,000 股計劃於 2026 年內完成上市流通。

### 資產抵押

於 2025 年 12 月 31 日，本集團並無任何資產用於抵押（2024 年：無）。

### 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。本集團的資本架構主要由本公司擁有人應佔權益（包括已發行股本及各類儲備）及銀行借款組成。於 2025 年和 2024 年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資本負債率來管理資本。本集團於 2025 年 12 月 31 日的資本負債率，即負債總額除以負債和所有者權益總計約為 26.63%（2024：27.62%）。

### 承諾及或有事項

#### 一、 重要承諾事項

	2025年	2024年
已簽約但未撥備 資本承諾	<u>11,779,295.64</u>	<u>9,619,477.16</u>

#### 二、 或有事項

於資產負債表日，本集團並無須作披露的或有事項。

## 員工情況

本集團為員工提供具有競爭力的薪酬福利，包括工資、獎金、社會保險、住房公積金、健康體檢、補充商業醫療保險等福利制度。本集團依法為員工提供各種休假，包括事假、病假、婚假、工傷假、喪假、年假、產假、陪产假等。本集團建立了完整的績效考核體系，通過有針對性的考核目標對每位元員工進行考核。本集團在每年年底根據員工績效評估結果，參考市場薪資情況，結合本集團目前的經營狀況制定薪資調整方案。同時本集團通過績效考核、人才晉升通道等綜合的人才評估機制，優化人才隊伍，以實現建設和發展一流人才團隊的發展目標。

## 未來展望

2026 年度，本集團將聚焦集成電路設計主業，以平台化運營為骨架、硬核技術為根基、持續創新為引擎，深耕高端通用芯片、特色專用芯片賽道，打造兼具技術護城河、市場話語權與行業影響力的國內芯片設計領軍企業。本集團將不斷鞏固提升在技術、服務、質量、品牌等方面的綜合競爭優勢，推進機制改革，激發創新活力，實現本集團的持續快速高質量發展。

### 產品技術方面

本年度研發工作將明確高性能國產化路徑，堅持自主創新，充分結合市場的需求變化，持續穩固技術優勢，將本公司長久以來積澱的“確定性、低延遲、高穩定”技術能力，打造成能令市場清晰感知並迫切需要的“差異化價值”；要同步加強研發體系與協同機制建設，著力提升創新效能與市場響應水平。

本公司將持續保障戰略性研發投入，穩步完善技術佈局，有序推進產品市場化。將通過深化產學研生態合作，彙聚和培養行業高質量人才，鍛造高效能研發團隊，不斷強化自主設計能力。

### 市場運營方面

做好大客戶服務，深化與大客戶的戰略綁定，持續提升系統解決方案與端到端服務能力。關注戰略性關鍵市場，避免同質化競爭，集中資源提升在重點行業的市場佔有率。

系統推進戰略市場的滲透與佈局，強化對客戶的導入、維護與深度協同，升級合作模式，建立價值共生的夥伴關係；通過精準產品定義與高質量交付服務樹立行業口碑，深化與國內上下游產業鏈及本土客戶的協同合作。同時，依托敏捷市場洞察能力驅動產品與解決方案迭代。

### 內部管理方面

面對外部環境的多重挑戰，本公司需在進取與穩健之間尋求動態平衡，重點攻堅有助於提升運營效能的專項任務。

加強項目的全過程管理，加快研發節奏。優化存貨結構，提升資產周轉效率與整體運營質量；強化供應鏈綜合管理能力，提升供應鏈韌性。推進多元化平台，統籌規劃、聚焦工藝、集中資源；積極推動與科研院所的協同合作，聚焦平台級關鍵技術攻關，完善創新佈局。

本公司將系統性強化合規風控體系建設，使組織既能快速響應市場變化，又能保持長期發展定力，為本公司在複雜環境中贏得可持續競爭優勢提供根本保障。

#### 集團化運作方面

在統一的戰略決策和標準化治理中凝聚合力，結合業務需求制定人才引進和培養計劃，打造穩健高效的核心團隊，配套激勵體系以激發各單元在合規框架內的經營活力與創新能動性。通過使命、願景、價值觀的系統傳播與行為牽引，使企業文化成為驅動協同、激發創新、增強韌性的核心引擎。

#### **末期股息**

董事會建議宣派截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息每 10 股人民幣 0.58 元(含稅) (2024 年：人民幣 0.80 元(含稅))，預計分配現金末期股息總額為人民幣 47,775,368.50 元(2024 年已派付：人民幣 65,714,184.00 元)。

在實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

上述建議須待於本公司即將舉行之股東週年會（「股東週年會」）上審議及批准後，方可作實。有關本公司暫停辦理股份過戶登記及宣派及派付股息的詳情將適時公佈。

#### **董事認購股份或債券的權利**

於本年度內，本公司之董事或彼等各自之配偶或其未成年子女概無獲授任何權利以購買本公司之股份或債券；本公司或其任何附屬公司亦概無參與任何安排，致使董事能夠在任何其他法人團體取得該等權利。

#### **董事進行證券交易**

本公司經已採納不遜於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C3所載的「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」。本公司經向所有董事明確查詢後，確定所有董事於截至2025年12月31日止年度內已遵守有關準則及守則。

#### **董事於交易，安排及合約中的權益**

於本年度內概無董事直接或間接地在與本公司或其附屬公司所訂立而對本集團業務有重大影響的交易，安排或合約中擁有重大權益。

## 優先購買權

根據本公司的公司章程或中華人民共和國法例，並無規定優先購買權條款。

## 購買、贖回或出售上市證券

於2025年12月30日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行了2,285,950股A股普通股，於2021年9月23日（即董事會批准激勵計劃並訂定發行條款之日）的A股收市價為每股A股人民幣38.80元，發行價格為每股人民幣17.62元，新增股本為人民幣228,595.00元，股本溢價為人民幣40,049,844.00元，募集資金總額及扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣40,278,439.00元，每張證券可得的淨價為人民幣17.62元，根據A股限制性股票激勵計劃之募集資金用途，所得款項已於2025年12月內用作日常流動資金。截至2025年12月31日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行在外的限制性股票為6,000份（進一步詳情請見本公司日期為2021年10月20日的通函；和2021年11月5日、2021年12月6日、2022年10月28日、2022年12月7日、2022年12月15日、2023年12月19日、2023年12月26日、2024年12月11日、2025年12月30日及2026年1月13日的海外監管公告）。根據本公司資本結構，如果發行在外的限制性股票全部歸屬，將發行6,000股額外本公司A股普通股。除上述所披露者外，本公司或其任何子公司於報告期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事於競爭業務之權益

本公司各董事於年內及直至本公告日止概無在與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭（定義見上市規則）之業務中擁有權益。

## 公眾持股量之足夠程度

根據本公司可取得之公開資料及就董事所知，於本公告日期，本公司已符合適用的公眾持股量要求，上市H股所屬類別之已發行股份總數（不包括庫存股份）的5%以上由公眾持有。

## 企業管治守則

本公司已採用上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）所列之守則條文，作為本公司之企業管治守則。

於截至2025年12月31日止整個年度內，本公司除偏離守則條文第C.2.1條（涉及主席角色分離）外，一直遵守企業管治守則，有關偏離情況闡釋如下：

根據守則條文第C.2.1條，董事長與董事總經理（「行政總裁」）的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，本公司董事長及董事總經理的角色均由張衛先生擔任。儘管董事長與董事總經理的職責由一人承擔，但本公司制定有董事會和總經理工作細則，對權限有明確規定，涉及應由董事會決策之事項，均會諮詢董事並提交董事會決策。董事會有2名執行董事、4名非執行董事、4名獨立非執行董事及1名職工董事。董事會認為已具備足夠的權力平衡，且現有管理層於本公司保持強大的管理地位。董事會同時認為，目前的企業架構可推動本公司策略的有效制定及實施，並促進有效及迅速地探索業務機遇。

## 結算期後事項

本集團並無任何重大的結算期後事項。

## 審核委員會

審核委員會已按照上市規則成立，並已訂定書面職權範圍，亦已分別上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司的網站內。審核委員會的主要職責是監察本集團財務呈報程序及內部控制和風險管理系統。現時審核委員會之成員為三名獨立非執行董事王美娟女士（主席）、石艷玲女士及胡雪先生。

本集團截至2025年12月31日止之財務報表已經該委員會審核，其意見為該等報告乃遵照適用之會計準則、聯交所及法例之規定，且經已作出足夠之披露。

## 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）的工作範圍

本公告中所載本集團截至2025年12月31日止年度之合併資產負債表、合併利潤表以及相關財務報表附註，已經本集團核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）與本集團於本年度的經審核財務報表所載的數額核對一致。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則項下的核證委聘工作，因此，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）並無就本公告發表核證。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
張衛先生  
董事長

中國，上海，2026年3月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閆娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

\*僅供識別